

高温ディップコーティング装置

商品番号: TB27



前書き

高温ディップコーティング装置は、プログラム可能な3ゾーン引き上げ、1000℃までの制御された炉内焼成、およびセラミックス、結晶、電池材料、ナノフィルム研究のための柔軟な雰囲気操作を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主な利点
セラミック薄膜開発	セラミック基板を液相コーティング材料に浸漬し、制御された加熱を通して引き上げ、膜を固化させます。	セラミック膜研究に関連する高温処理条件をサポートします。
結晶膜研究	結晶ベースの薄膜研究のために、プログラムされた基板引き上げと炉処理を提供します。	個別に制御された移動ゾーンにより、コーティングサイクル中の再現性のある熱曝露をサポートします。
電池材料膜研究	制御されたディップコーティングと高温固化が実験開発の一部である電池材料膜を処理します。	コーティング動作と炉処理を1つの明確なワークフローに統合します。
特殊ナノフィルム作製	液相膜材料から形成される特殊なナノフィルムを含む研究をサポートします。	調整可能な速度と滞留設定により、プロセス変数の制御された調査が可能です。
不活性雰囲気コーティング実験	窒素、アルゴン、またはその他の安全な不活性保護ガスを使用してコーティングおよび加熱研究を行います。	研究者が実験プロセスに適した保護雰囲気を選択できるようにします。
酸化雰囲気熱処理	酸化雰囲気での使用を必要とするディップコーティングワークフローをサポートします。	雰囲気依存の膜挙動を比較するための柔軟なプラットフォームを提供します。
大学および機関の材料研究	将来の高温成膜技術を調査する実験室プログラムに貢献します。	簡単なタッチスクリーン操作と便利な洗浄が、頻繁な実験使用をサポートします。

パラメータ	仕様
製品アイテム番号	TB27
製品名	高温ディップコーティング装置
製品モデル	TB27
設置電源	単相AC220V 50/60Hz、国家規格10Aソケット x2
接地要件	良好な接地が必要
フロントエンド保護要件	16A空気遮断器が必要
設置場所温度	25°C +/-15°C
設置場所湿度	55%Rh +/-10%Rh
引き上げ本体動作電圧	DC24V 3.75A; 標準AC100-240V電源アダプター

パラメータ	仕様
引き上げ本体定格電力	50W
タイプ	高温炉付きプログラム制御高温タイプ
駆動モーター	高精度ステッピングモーター
速度設定範囲	3段階動作; 各段階個別に設定; 1-200 mm/min
焼成滞留時間	1-999 s
総移動距離	低温ゾーン + 高温ゾーン + 冷却ゾーン = 620 mm
第1段階移動（低温ゾーン）	236 mm（調整不可）
第2段階移動（高温ゾーン）	150 mm（調整不可）
第3段階移動（冷却ゾーン）	234 mm（調整不可）
有効浸漬長	60 mm
最大引き上げ負荷	<=200 g
サンプル基板サイズ	L75 mm x W25 mm x D1-4 mm
表示および制御	4.3インチカラータッチスクリーン
全体寸法	幅560 mm x 奥行470 mm x 高さ1550 mm
全体重量	約50 kg（高温炉を含む）
高温炉動作電圧	単相AC220V 50/60Hz
高温炉定格電力	1.5KW
最高加熱温度	1100°C
定格加熱温度	1000°C
標準引き上げワイヤーの動作温度範囲	RT（室温）～ +800°C
標準引き上げワイヤーの動作条件	800°C以下に適しています
800°Cを超える場合の引き上げワイヤー要件	800°C～1000°Cの動作には特別なカスタマイズまたはお客様提供のワイヤーが必要
推奨加熱速度	10°C/min
温度制御精度	+/-1°C
温度制御および設定方法	インテリジェント温度レギュレーター、多段温度コントローラー
熱電対	K型
炉室寸法	Phi80 mm x 330 mm
炉管仕様	外径Phi50 mm x 内径Phi45 mm x 長さ600 mm
付属電源アダプター入力	AC100-240V 50/60Hz
付属電源アダプター出力	DC-24V 3.75A
実際の装置電源基準	製品背面の銘板仕様が優先されます
オプションの炉電源	カスタマイズ可能な単相AC110V 50/60Hz